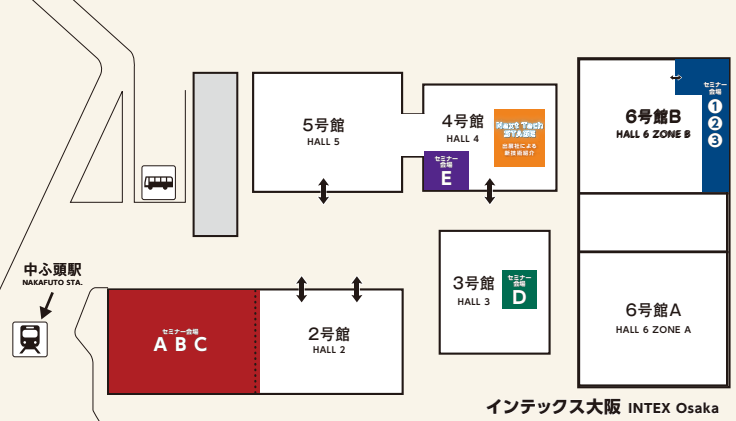


セミナー会場一覧

Conference Schedule

セミナー会場は複数ございます。必ずご確認ください。



マイページはこちら
ACCESS MY PAGE FROM HERE

新規申込はこちら
REGISTER NEW SESSION FROM HERE

- <注意事項>
- セミナー受講に必要な持ち物は2点です。
 - ① 展示会場入場に必要な来場者パスジ^{※1}
 - ② セミナー受講に必要な受講券^{※2}
 - 敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
 - 一部テキスト(講演資料)配付の無いセッションがございます。
 - セミナーの録音・写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。
- ※1 セミナーのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者パスジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 セミナー申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日会場入場受付で提示してください。(印刷・スマホ上での提示、どちらでも可)

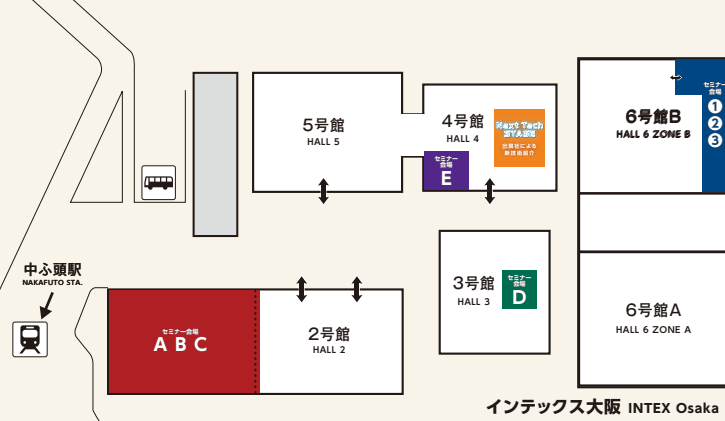
5月13日[水] Wed. May. 13

START	セミナー会場A	セミナー会場B	セミナー会場C	セミナー会場D	セミナー会場E	Next Tech STAGE	セミナー会場①	セミナー会場②	セミナー会場③	START
	1号館 Hall 1	1号館 Hall 1	3号館 Hall 3	3号館 Hall 3	4号館 Hall 4	4号館 Hall 4	6号館B Hall 6 ZONE B	6号館B Hall 6 ZONE B	6号館B Hall 6 ZONE B	
10:00										10:00
10:30	10:30-11:15 RTJ-1 PPWR規制とセキュアエレクトロニクスと欧州規制の影響による素材技術の最新動向	10:30-11:15 PLA-1 次世代高速通信向け材料の研究開発支援と研究紹介	10:30-11:15 FILM-1 EMC対策と磁気ノイズ抑制シートの有効性	10:30-11:15 CERA-1 負熱膨張材料BNFO～への電圧制御材料～	10:30-11:15 PHOTO-1 レーザー溶接モニタリングの最新動向	10:30-11:15 EX-1 日本発の最先端AI部品の取組	10:30-11:40 NEPCON-S1 自動化・生成AI・X線CTで描く次世代エレクトロニクス製造の未来像	10:30-11:40 FIW-S1 「開発・生産・運用」のコミュニケーションは「信頼」で繋がる！	10:30-11:35 NEPCON-O1 高品質製造・技術・高信頼性に向けたプリント配線板の技術開発動向	10:30
11:00	次世代高速通信向け基礎材料開発について	次世代高速通信向け基礎材料開発について		次世代デジタルセラミックスの研究開発	レーザー溶接モニタリングの最新動向	日本発の最先端AI部品の取組		「開発・生産・運用」のコミュニケーションは「信頼」で繋がる！	高品質製造・技術・高信頼性に向けたプリント配線板の技術開発動向	11:00
11:30										11:30
12:00										12:00
12:30	12:15-13:45 MW-S1 MOFの社会実装に向けて「バネ」の活用	12:15-13:00 SUSMA-1 次世代高速通信向け材料の研究開発支援と研究紹介	12:15-13:00 FILM-2 プラスチックゴミゼロへの挑戦	12:15-13:00 SUSMA-11 ラベル自給の水平リサイクル事業	12:15-13:00 EHC-K1 職場における熱中症防止対策について		12:30-13:40 NEPCON-K 先進パッケージが響く次世代半導体の革新	12:30-13:40 FIW-S2 本場のDX文化をつくる組織と現場	12:30-13:35 NEPCON-O2 新素材DX(トヨタ)とHan L (BYD)に搭載されたインバータの最新動向	12:30
13:00	MOFの社会実装に向けて「バネ」の活用	次世代高速通信向け基礎材料開発について	プラスチックゴミゼロへの挑戦	ラベル自給の水平リサイクル事業	職場における熱中症防止対策について		先進パッケージが響く次世代半導体の革新	本場のDX文化をつくる組織と現場	新素材DX(トヨタ)とHan L (BYD)に搭載されたインバータの最新動向	13:00
13:30										13:30
14:00										14:00
14:30										14:30
15:00	15:00-16:30 RTJ-S プラスチックのセキュアエレクトロニクス	14:00-14:45 PLA-2 AI半導体向け大型パッケージ基盤用材料、先進バネ材料の最新動向	14:00-14:45 MW-1 研究データの統合と活用が企業競争力を決める	14:00-14:45 RTJ-2 リマニュファクチャリングに利用可能な解熱性材料の開発	14:00-14:45 SUSMA-2 資源効率を高める国内外の規制動向とサステナブルなパッケージの方向性		15:00-16:10 NEPCON-S2 シリコン列島の波は全国各地に拡大はじめた!	15:00-16:10 FIW-S7 深層学習とAIの融合	14:30-15:35 NEPCON-O3 AI融合社会を支える見えぬ主役	15:00
15:30	プラスチックのセキュアエレクトロニクス	AI半導体向け大型パッケージ基盤用材料、先進バネ材料の最新動向	研究データの統合と活用が企業競争力を決める	リマニュファクチャリングに利用可能な解熱性材料の開発	資源効率を高める国内外の規制動向とサステナブルなパッケージの方向性		シリコン列島の波は全国各地に拡大はじめた!	深層学習とAIの融合	AI融合社会を支える見えぬ主役	15:30
16:00										16:00
16:30										16:30
17:00										17:00

セミナー会場一覧

Conference Schedule

セミナー会場は
複数ございます。
必ずご確認ください。



マイページは
こちらから
ACCESS MY PAGE FROM HERE

新規申込は
こちらから
REGISTER NEW SESSION FROM HERE

- <注意事項>
- セミナー受講に必要な持ち物は2点です。
 - ① 展示会場入場に必要な来場者パスジ^{※1}
 - ② セミナー受講に必要な受講券^{※2}
 - 敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
 - 一部テキスト(講演資料)配付の無いセッションがございます。
 - セミナーの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。
- ※1 セミナーのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者パスジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 セミナー申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日会場受付で提示してください。(印刷・スマホ上での提示、どちらでも可)

5月14日[木] Thu. May. 14

START	セミナー会場A 1号館 Hall 1	セミナー会場B 1号館 Hall 1	セミナー会場C 2号館 Hall 2	セミナー会場D 3号館 Hall 3	セミナー会場E 4号館 Hall 4	Next Tech STAGE 出展社による新技術紹介 4号館 HALL 4	セミナー会場① 6号館B HALL 6 ZONE B	セミナー会場② 6号館B HALL 6 ZONE B	セミナー会場③ 6号館B HALL 6 ZONE B	START		
10:00										10:00		
10:30	10:30-11:15 RT-J-3 プラスチックのケミカルリサイクル 最新技術動向 <small>住友化学(株) 住友化学株式会社 住友化学 住友化学</small>	10:30-11:15 SUSMA-4 [NGKの事例に学ぶ] サステナ技術や施策がもたらす価値の ESG定量化 <small>NGK(株) NGK株式会社 エス・イー・システムズ(株) エス・イー・システムズ 住友化学(株) 住友化学株式会社</small>	10:30-11:15 FILM-3 多くの製品をサポートする粘着技術 <small>リソテック(株) リソテック株式会社 上野博明 石崎 悠夫</small>	10:30-11:00 CERA-2 <small>大塚化学(株) 大塚化学 高橋 啓樹</small>	10:30-11:15 PHOTO-3 ガラスのレーザー加工の基礎と最新動向 <small>京浜東北大学 理工学部 数理工学系 高橋 啓樹</small>	10:30-11:15 EX-5 日本発着産AM部会員の取組む 金属3Dプリント実用例 <small>トランスコム(株) トランスコム株式会社 山本 元亮</small>	10:30-11:40 FIW-S3 新産業からこそ必要な生産AI活用 ～最新事例を学ぶ～ <small>パナソニック コネクテッド 新技術開発 VP 藤田 浩二 ボクシング(株) 新技術開発 VP 藤田 浩二 日立(株) 電子部品システムセンター 製品開発部 藤田 浩二</small>	10:30-11:40 NEPCON-S3 ノイズ対策最新 フロントロードインジェクションと 単層40V電源システムの最新技術 <small>住友化学(株) 住友化学株式会社 住友化学 住友化学 TDK(株) 電子部品システムセンター 製品開発部 藤田 浩二</small>	10:30-11:35 NEPCON-O4 AIサーバーの高速化の動向と必要とされる材料 448Gbit/s対応するAI <small>OKIエレクトロニクス(株) マーケティング部長 飯島 裕</small>	10:30		
11:00										11:00		
11:30										11:30		
12:00										12:00		
12:30	12:15-13:45 SUSMA-5 自動車用革新素材の最新動向 ～最新技術動向～ [パネルディスカッション] <small>トヨタ自動車(株) トヨタ自動車株式会社 住友化学(株) 住友化学株式会社 住友化学(株) 住友化学株式会社</small>	12:15-13:00 PLA-5 車載電子部品と材料設計の革新 <small>(株)アパックス(株) アパックス株式会社 荒尾 啓</small>	12:15-13:00 EHC-K2 バイタル分析×AIによる集中症対策を営む 次世代の歯く環境看護への挑戦 <small>NTTPコミュニケーションズ(株) AIソリューション事業部 ソリューションデザイン部 藤田 啓</small>	12:15-13:00 RT-J-2 自動車用樹脂による「XtoCAR」 プラスチックリサイクルへの挑戦 <small>大塚化学(株) 大塚化学 高橋 啓樹</small>	12:15-13:00 PHOTO-2 高出力半導体レーザーとホットワイヤを用いた 溶接・接合技術開発 <small>京浜東北大学 理工学部 数理工学系 山本 元亮</small>	12:00-12:45 EX-6 レアメタルの安定確保を目指して <small>(株)AMERIGO(株) 山田 啓</small>		12:30-13:40 FIW-S4 労働力不足時代の現場革新 ～ヒト×ロボットの次世代ものづくり <small>カブツロ(株) 山本 啓 アサヒ(株) 生産技術センター 山本 啓</small>	12:30-13:40 NEPCON-S4 光電融合を実現する キーテクノロジーの最新動向 <small>住友化学(株) 住友化学株式会社 住友化学 住友化学 住友化学(株) 住友化学株式会社 住友化学 住友化学 住友化学(株) 住友化学株式会社 住友化学 住友化学</small>		12:30	
13:00										13:00		
13:30										13:30		
14:00										14:00		
14:30										14:30		
14:45	14:45-16:15 FIW-S2 材料系企業が仕掛ける「インバージョン」 [パネルディスカッション] <small>(株)アサヒ(株) アサヒ株式会社 住友化学(株) 住友化学株式会社 住友化学(株) 住友化学株式会社</small>	14:00-14:30 EHC-3 作業エリアのみを冷やすエアカーテンを利用した 「ゾーン空調システム」技術 <small>住友化学(株) 住友化学株式会社 住友化学 住友化学</small>	14:00-15:30 SUSMA-6 再生プラスチック本格活用促進の大会 ～日本発着産三番認定規格SPC認証プログラムの ウラナシ～ <small>大塚化学(株) 大塚化学 高橋 啓樹</small>	14:00-14:45 SUSTECH-1 強靱性と分離性を両立する ポリエステル材料設計 <small>大塚化学(株) 大塚化学 高橋 啓樹</small>	14:00-14:45 FILM-K 新しい高機能フィルム製品及び 研究開発への取り組み <small>(株)AEC(株) AEC株式会社 マーケティング 藤田 啓</small>	13:30-14:15 EX-7 「サステナブル」価値を支えるLCA ～素材企業における環境情報の役割～ <small>(株)AEC(株) AEC株式会社 マーケティング 藤田 啓</small>				13:00-13:30 NEPCON-O5 第3期発行IEC 61000-4-2 <small>(株)ノイズ(株) ノイズ株式会社 住友化学(株) 住友化学株式会社 住友化学(株) 住友化学株式会社</small>		14:00
15:00										15:00		
15:30										15:30		
16:00										16:00		
16:30										16:30		
17:00										17:00		
15:00										15:00		
15:30										15:30		
16:00										16:00		
16:30										16:30		
17:00										17:00		

